信頼性不足

## 2-1-2-15 鉄基板 SR 引抜擦り傷 / 铁基板的 SR 拉伤 / Scratch on solder resist of iron-base board by board pulling

【特徴】鉄基板のSR表面の比較的浅い引きずり傷、 傷部が錆びている場合あり

【特征】铁基板的 SR 表面有比较浅的拉伤,伤痕有 时氧化。

[Characteristics] A relatively shallow scratch on the solder resist surface on an iron-base printed board. Scratched part is often rusted.

【原因・判断ポイント・発生工程】高く積み重ねたボー ドの中から一部のボードを無理に引き抜いたことに より出来たもの(SR塗布乾燥後工程)

【原因、判断要点、发生工序】板件从堆垛中硬拉出 来而引起的(SR 涂布烘干后工序)。

## [Causes/processes involved/keys to judgment]

The scratch is formed by pulling out one or some boards forcibly from a high stack of boards. (After solder resist application process)



## 2-1-2-16 SR 滴下付着 / SR 的滴下并附着 / Drop of solder resist ink

【特徴】表面に滴下した様相で、付着しているSR 汚れ欠陥

【特征】在表面有滴下的摸样, 附着的 SR 沾污的缺陷。

[Characteristics] Dirty solder resist surface caused by a drop of solder resist ink

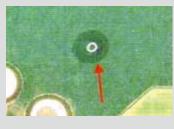
【原因・判断ポイント・発生工程】SR塗布後の表 面に液状のSRインクを誤って滴下させてしまった ことにより出来たもの(SR塗布乾燥後工程)

【原因、判断要点、发生工序】错误地将液体的 SR 滴下到 SR 烘干表面所引起的 (SR 烘干后工序)。

## [Causes/processes involved/keys to judgment] Liquid solder resist ink is carelessly dropped on the coated solder resist surface (After solder resist application process)



【コメント】 顕微鏡倍率× 10 【注释】 显微镜倍率 × 10 Magnification: ×10



【コメント】 顕微鏡倍率× 40 显微镜倍率 × 40 [Coments]

Magnification: ×40